

# Содержание журнала «Производство электроники» за 2016 г.

## РЫНОК

ПЭ № 1 (ЭК № 2), с. 106 *Интервью с Вадимом Лысовым*  
«Доверенная электроника» – воспользоваться  
очередным шансом

ПЭ № 1 (ЭК № 2), с. 110 *Сергей Веретенников*  
Premix Oy поможет наладить в России производство  
токопроводящей упаковки

ПЭ № 2 (ЭК № 4), с. 106 «ЭкспоЭлектроника» – 2016:  
в фокусе импортозамещения

ПЭ № 2 (ЭК № 4), с. 108 *StarLine* решил «Победит»ь.  
Об опыте развития производства автоэлектроники  
в России

ПЭ № 2 (ЭК № 4), с. 113 *Cadence Design Systems*  
и официальный дистрибьютор «ПСБ СОФТ» проводят  
семинары по OrCAD, Allegro и Sigrity

ПЭ № 2 (ЭК № 4), с. 114 Добротное российское  
оборудование для мелкосерийного поверхностного  
монтажа

ПЭ № 3 (ЭК № 6), с. 98 *Сергей Комаров*  
Основные направления развития технологий,  
оборудования и материалов для производства  
печатных плат

ПЭ № 4 (ЭК № 9), с. 98 Эволюция образования  
и кадровой политики в преддверии технического  
рывка

ПЭ № 4 (ЭК № 9), с. 102 Оценка регулирующего  
воздействия заградительных таможенных пошлин  
на рынок электроники

ПЭ № 5 (ЭК № 10), с. 98 От инноваций до практических  
вопросов производства печатных плат

ПЭ № 6 (ЭК № 12), с. 98 *Юрий Курочкин*  
Производство электроники – 2016. Возможности  
и перспективы

ПЭ № 6 (ЭК № 12), с. 101 *Юрий Курочкин*  
От входного до выходного контроля: как производится  
электроника ответственного применения

## ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

ПЭ № 1 (ЭК № 2), с. 111 *Сергей Комаров*  
Исследовательская и научно-производственная  
инфраструктура для разработчиков и производителей  
печатных плат

ПЭ № 1 (ЭК № 2), с. 114 *Грегор Лангер, Маркус Ляйтгеб,*  
*Йохан Николикс, Михаэль Унгер, Ганс Хошофф,*  
*Франц Венцель*

Новые решения по управлению тепловыми режимами  
печатных плат для применения в мощных силовых  
устройствах. Часть 1

ПЭ № 2 (ЭК № 4), с. 118 *Грегор Лангер, Маркус Ляйтгеб,*  
*Йохан Николикс, Михаэль Унгер, Ганс Хошофф,*  
*Франц Венцель*

Новые решения по управлению тепловыми режимами  
печатных плат для применения в мощных силовых  
устройствах. Часть 2: Печатные платы со специально  
сформированными окнами и покрытые медью  
теплоотводные переходные отверстия

ПЭ № 2 (ЭК № 4), с. 124 *Сергей Пурыжинский, Дмитрий*  
*Лебалк, Кирилл Жуков, Сергей Рышкевич, Артем Кочанов*  
Формирование устойчивого контакта между слоями  
многослойной тонкопленочной платы

ПЭ № 5 (ЭК № 10), с. 100 *Александр Акулин*  
10 причин перейти на новый релиз САПР печатных  
плат Cadence Allegro/OrCAD 17.2-2016

ПЭ № 5 (ЭК № 10), с. 104 *Александр Акулин*  
Почему стоит перейти на САПР печатных плат  
Allegro 17.2-2016? Продвинутая поддержка  
проектирования гибких и гибко-жестких плат 2016

ПЭ № 6 (ЭК № 12), с. 106 *Александр Акулин*  
Почему стоит перейти на САПР печатных плат  
Allegro 17.2-2016?

ПЭ № 6 (ЭК № 16), с. 112 *Олег Греков, Артем Кочанов,*  
*Дмитрий Лебалк*  
Многослойные платы: технологии и материалы

## КОНТРОЛЬ И ТЕСТИРОВАНИЕ

ПЭ № 3 (ЭК № 6), с. 118 *Людмила Бойкова*  
Количество качества: измерения в АОИ и SPI

## МОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ

ПЭ № 4 (ЭК № 9), с. 110 *Ксения Бунатян, Артем Вахитов*  
Стопроцентное измерение параметров нанесения  
паяльной пасты без снижения скорости

ПЭ № 4 (ЭК № 9), с. 114 *Светлана Пескова*  
О флюсовании и российской продукции для пайки

ПЭ № 5 (ЭК № 10), с. 110 *Пауль Вильд*  
Пайка с вакуумом или без него? Гибкое решение «2 в 1»  
для пайки оплавлением

ПЭ № 5 (ЭК № 10), с. 113 *Александр Часовской*  
Высокоточный настольный пневматический дозатор от компании Nordson

ПЭ № 5 (ЭК № 10), с. 114 *Тим О'Нил*  
«Точка за точкой» или О дозированной подаче паяльной пасты

### НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПЭ № 1 (ЭК № 2), с. 118 *Крис Рейнольдс*  
Новые технологии в изготовлении встраиваемых компонентов

ПЭ № 1 (ЭК № 2), с. 122 *Питер Сонтимер*  
Новые контактные штыри, монтируемые методом Press-Fit, для непаяной сборки

ПЭ № 2 (ЭК № 4), с. 126 *Ханчен Хуанг*  
Металлосодержащие клеи: теплоотводящие адгезивы, проводники и герметики

ПЭ № 5 (ЭК № 10), с. 106 *Сидни Кокс*  
Материалы ГПП для высокотемпературных применений

### ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПЭ № 5 (ЭК № 10), с. 116 *Сергей Комаров*  
Новые стандарты по электростатике и клеммным колодкам для печатного монтажа

### ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПЭ № 1 (ЭК № 2), с. 124 *Валерий Парковский, Владимир Ланин*  
Компоновка высокоскоростных электронных модулей

ПЭ № 3 (ЭК № 6), с. 100 *Илья Лейтес*  
DFM не теряет актуальность в России

ПЭ № 3 (ЭК № 6), с. 108 *Александр Акулин*  
Решение проблем целостности сигналов и питаний при разработке интерфейсов памяти на основе DDR3/DDR4

### ТЕХНОЛОГИИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

ПЭ № 3 (ЭК № 6), с. 114 *Бруно Толла, Янронг Ши, Сянг Вей*  
Химическое влияние на надежность сложных сборок. Часть 1

ПЭ № 4 (ЭК № 9), с. 117 *Бруно Толла, Янронг Ши, Сянг Вей*  
Химическое влияние на надежность сложных сборок. Часть 2